

㈱東設  
代表取締役

## 押部 弘氏



電解めっき装置メーカーの㈱東設（埼玉県入間市）が事業拡大のチャンスを迎えている。主力の電子部品向けに加え、半導体関連からめっき装置への引き合いが増えているためだ。現在の取り組みや今後の展望を代表取締役の押部弘氏に聞いた。

# 電解めっき装置への引き合い増加

製造装置とともに使用されている。残り1割程度が、水や薬液中に溶け込んでいる酸素などのガス

——直近では半導体関連からの引き合いが増えている。

——生産体制について

——今後の戦略は。

——今後の抱負をお聞かせ下さい。

——聞き手・特別編集委員 津村明宏

# 半導体パッケージ関連で大判化も

成分や気泡を取り除く脱気システムだ。

——直近では半導体関連からの引き合いが増えている。

——今後の抱負をお聞かせ下さい。

——今後の抱負をお聞かせ下さい。

——聞き手・特別編集委員 津村明宏

——貴社の事業構成から伺います。

押部 売上高の約7割を占める電解めっき装置は、最大12インチまでの量産用をはじめとして研究開発や試作用にも提供しており、その多くをユーザーのプロセスや要望に応じたカスタム仕様で製造している。縦にした

・カセット（C2C）搬送のフェイスアップ方式およびフェイスダウン方式の装置をラインアップしており、なかでもフェイスアップ方式で多くの出荷実績がある。

押部 近年は台数ベースでは縦型ティップ式が増えているが、当社の強みはフェイスアップ方式にある。面内の膜厚均一性や合金の組成安定性に優れており、これまでにパラロイやインバーなどのNiFe合金、あるいはFeCo/NiFe

押部 半導体パッケージ基板の大型化に伴い、ガラス基板をキャリアに用いるパネルレベルパッケージへの関心が高まっていることに加え、内層にガラスを用いるガラスコア基板も登場してきたことで、半導体後工程ライクなRDL（再配線工程）や高アスペクト比の

押部 本社工場に加え、2024年に入ってから近接地に中神事業所を本格的に立ち上げ、先ごろ中神事業所で製造した1号機を出荷した。生産を本社から中神事業所へ段階的に移しており、生産キャパシティは従来比で2倍となった。AIスマートフォン用の電

押部 電子部品から半導体分野へ顧客が多様化

つき装置の試作機を、24年度内の完成を目指して開発中だ。装置の構造や液残りの処理対応などを詰めている段階で、C2Cのフェイスアップ方式で実現したいと思っています。

24年度（25年3月期）の売上高は18億円、



中神事業所

